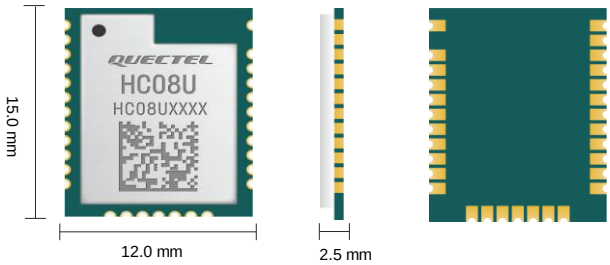
Quectel HC08U

BLE 5.1 模块
小尺寸 LCC 封装



HC08U是移远通信推出的一款高性能蓝牙模块，其处理器主频高达64 MHz，支持BLE 5.1，内置64 KB SRAM以及512 KB flash。

HC08U为贴片LCC封装，超紧凑的封装尺寸15.0 mm × 12.0 mm × 2.5 mm，能最大限度地满足终端产品对小尺寸模块产品的需求，兼容多样化的结构设计。

在QuecOpen®方案下，HC08U支持多达20个GPIO，可复用为UART、SPI、I2C、ADC以及PWM等接口。多种低功耗模式和长连接保活机制，使其可灵活、广泛地应用于智能家居和工业物联网等应用场景，满足不同的场景需求。

产品特性

- 支持 BLE 5.1
- 超宽工作温度范围：-40 °C ~+85 °C
- 采用 LCC 封装，方便客户焊接与测试
- 多达20个GPIO，可复用为UART、SPI、I2C、ADC及PWM等外设接口
- 支持外置引脚天线



Quectel HC08U

蓝牙	HC08U
蓝牙协议	蓝牙 5.1
加密模式	AES
工作模式	BLE
内核	RISC 处理器（主频高达64 MHz）
SRAM	64 KB
Flash	512 KB
模块尺寸	15.0 mm × 12.0 mm × 2.5 mm
重量	约0.75 g
温度	
工作温度	-40 °C ~ +85 °C
存储温度	-45 °C ~ +95 °C
认证	
强制认证	**中国：**SRRC **欧洲：**CE **美国：**FCC **加拿大：**IC **澳大利亚/新西兰：**RCM
其他认证	Bluetooth
接口	
天线接口	× 1
外设接口①	UART/ SPI/ I2C/ PWM/ ADC/ GPIO
供电电压	
电源供电电压	1.8–3.6 V，典型值3.3 V
射频性能	

		接收灵敏度	发射功率
BLE	1 Mbps	-92 dBm ±2 dB	5 dBm ±2 dB
	2 Mbps	-87 dBm ±2 dB	5 dBm ±2 dB

采购编码	Flash	工作温度范围	天线	开发板（仅调试）
HC08UABMD	512 KB	-40 °C ~ +85 °C	外置引脚天线	HC08UABEV

备注：
①：接口详情可参考模块的硬件设计手册。

Copyright © 2023 上海移远通信技术股份有限公司 All Rights Reserved http://www.quectel.com
总部地址：上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼 邮编：200233
电话：+86 21 51086236 邮箱：info@quectel.com